tSML - LWL Breakoutmodul 19"/0.5HE gerade 4x MPO/MTP® m. Pins/16x LC APC Duplex 9/125µ OS2 40GbE

\*\*tSML - tde Semi Modular Link

tSML ist ein modular aufgebautes Verkabelungssystem, das aus zwei Kernkomponenten besteht: Modul und Trunkkabel. Es handelt sich hierbei um vorkonfektionierte getestete Systemkomponenten, die vor Ort insbesondere in Rechenzentren eine Plug & Play Installation innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Die LWL und TP Module können mit ihren Abmessungen von 19" 0,5HE zusammen innerhalb einer Höheneinheit mit sehr hoher Portdichte kombiniert eingesetzt werden. Bis zu 96x LWL Duplex bzw. 48x RJ45 Ports sind so auf 1HE möglich. Das Herz des Systems sind die rückseitigen MPO/MTP® und Telco Steckverbinder, über die mindestens 6 Ports mit 10GbE bzw. GbE Performance auf einmal verbunden werden können.

\*\*tSML - LWL Breakoutmodule 19"/ 0.5HE

\*\*TECHNISCHE\_DATEN

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP®Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm. Alle Systemkomponenten (Module, Trunkkabel und Patchkabel) sind zur Erreichung der Performance speziell aufeinander abgestimmt. Das Modul ist beschriftet mit fortlaufender Seriennummer und Artikelnummer. Die Module sind ROHS-konform.

|  |  |
| --- | --- |
| Eingang | 4 x MPO/MTP®Male Kupplung (grün) frontseitig |
| Ausgang | 16 x LC APC Duplex Kupplungen (grün) frontseitig |
| Tests | Interferometermessung, Einfüge- und Rückflußdämpfungsmessungen und visuelle Endkontrolle; alle Messwerte sind elektronisch abrufbar |
|   | QS-Managementsystem nach ISO 9001, ISO 14001 und TL 9000 |

\*\*\*tSML - LWL Module 19"/ 0.5HE

|  |  |
| --- | --- |
| Gehäuse | Edelstahl |
| Frontplatte | Edelstahl |
| Abmessungen | 19", 0.5 HE, Tiefe 11 cm |

\*\*\*LWL Adapter

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | MPO/MTP® |
| Anwendung | Singlemode OS2 APC |
| Bauform | ohne Flansch |
| Einbauform | SC Simplex |
| Orientierung | Typ A, Key up/down |
| Farbe | Grün |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | -- |
| Klappe | -- |
| Standards | IEC 61754-7 TIA 604-5 |
| Hersteller | US Conec |

\*\*\*LWL Steckverbinder

Die Endflächen der Steckverbinder sind mittels Lasercleaving und Maschinenpolitur optimiert. Die MPO/MTP® Stecker besitzen einen definierten Faserüberstand von 1 - 3.5µ. Die Max. Höhendifferenz benachbarter Fasern beträgt 0.2µm und die aller Fasern 0.3µm.

|  |  |
| --- | --- |
| Stecker | MPO/MTP® APC Male Push Pull Verriegelung mit Elite Pins (Grün) |
| Ferrule | 12 Faser SM Elite® Ferrule, PPS |
| Tüllenfarbe | Schwarz |
| Temperaturbereich | -40°C bis +75°C |
| Hersteller | tde/US Conec |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
| 9/125µ OS2 | MPO/MTP®APC | 1550 nm | ≤ 0.10 dB | 0.20 dB | 75 dB |

\*\*\*LWL Adapter

|  |  |
| --- | --- |
| Typ | LC Duplex |
| Anwendung | Singlemode OS2 APC |
| Bauform | One-Piece ohne Flansch |
| Einbauform | SC Simplex |
| Farbe | Grün |
| Material | Kunststoff |
| Hülse | Keramik |
| Klappe | -- |
| Hersteller | tde |

\*\*\*LWL Steckverbinder

|  |  |
| --- | --- |
| Stecker Typ | LC APC Unibody Simplex |
| Gehäuse | Kunststoff, Grün |
| Ferrule | Keramik, Axial gefedert |
| Ferrul-Bohrung | 125.5 µ |
| Ferrul-Konzentrizität | ≤ 0.6 µ |
| Steckzyklen | 500 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +75°C |
| Zugentlastung bis | 100 N |
| Hersteller | tde |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faser | Typ | Wellenlänge | Einfügedämpfung typ. | Einfügedämpfung max. | Rückflussdämpfung min. |
| 9/125µ | LC APC | 1550 nm | ≤ 0.10 dB | 0.18 dB | 75 dB |